证券代码：603690 证券简称：至纯科技

**上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议  □ 媒体采访 □ 业绩说明会  □ 新闻发布会 □ 路演活动  □ 现场参观 √ 券商策略会  □ 其他 |
| 参与机构 | 中欧基金、高信百诺资管、华泰资管、海通资管、弥远投资、钦沐资产、北方工业有限公司、UG FUND、Eagle Group、华泰证券、华福证券、天风证券、东方证券等 |
| 时间 | 2025年6-7月 |
| 地点 | 现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘任慕华、证代张娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **交流的主要问题及回复概要**   **1、公司2025年上半年整体订单和经营情况如何？**  答：2025年上半年，公司整体经营稳定，业务订单正常开展，详细情况请以公司2025年半年度报告为准。  **2、公司湿法设备业务有何进展？先进制程高端机进展情况如何？**  答：2024年公司对设备进行技术升级，优化改造，公司旗下至微科技发布了S300-D湿法设备新平台，该平台专为先进制程需求设计，覆盖SPM、BACKSIDE ETCH（背面蚀刻）、Pre clean（预清洗）、BEVEL（斜边处理）等关键工艺，其WPH（每小时处理晶圆的数量）提升30%，新平台显著提升了生产效率，并在腔体的缩小和流场的控制方面有了进一步提升以满足更苛刻的工艺需求。  公司于2022年正式推出的高温硫酸SPM设备，成为国产首台应用于大规模量产线的12英寸硫酸清洗机，月产能最高可达6万片次，单机累计产量已超过70万片次，是高阶湿法设备国产替代进口的重要里程碑。  未来公司将聚焦先进制程的产品与服务，把握好目前先进制程湿法工艺验证领先的优势，希望在下游集成电路客户先进制程有重大进展时抓住机遇，提升公司半导体设备业务比重。   1. **国内目前清洗设备的竞争格局如何？**   答：国内清洗设备行业目前处于快速发展阶段，国产替代加速，国内也有数家湿法设备企业。中低阶清洗设备厂商众多，产品同质化严重，价格竞争激烈；高阶清洗设备技术门槛较高，主要仍由外资品牌主导。公司湿法设备产品聚焦晶圆制造的前道工艺，主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等关键工序段前后，在28纳米节点设备开发已经全部完成，且全工艺机台均有订单，在更先进制程节点，至微也已取得较多道数工艺订单，尤其在高温硫酸、FIN ETCH、单片磷酸等尚被国际厂商垄断的机台，公司交付和验证进度都在国内领先。   1. **公司湿法设备能替代国外进口的设备吗？**   答：公司湿法设备用户已经覆盖大部分核心客户并为其配套关键工艺节点的湿法工艺设备。在28纳米率先实现前中后段全工艺覆盖，在更先进制程节点正陆续替代国外厂商。公司不仅实现了工艺机台的全自主IP，还砥砺五年多时间基本实现了核心模组到功能单元再到元器件层的本土供应链培育和建设。   1. **电子材料业务进展如何？**   答：公司大宗气站的业务进展顺利。由公司投资和设计建设的国内首座完全国产化的12英寸晶圆对应28纳米的大宗气体供应工厂指标完全达标，为用户提供至少15年的高纯大宗气体供应，从2022年初至今持续稳定运行，成功打破了半导体级大宗气由国际供应商垄断的格局，实现了该制程节点国内自主大宗气站零的突破。目前公司第二座大宗气站于2024年上半年已开始为客户提供供气服务，随着客户的产能爬升，预计2025年将为公司贡献更可观的营收及现金流。   1. **收购威顿晶磷目前进展如何？**   答：本次收购威顿事项涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进当中，公司持续推进本次交易的相关工作并将在相关工作完成后召开会议审议本次交易的相关事项并公告。   1. **请问现在手头的订单按照下游的行业来拆分，大概是一个什么样的情况？**   答：2024年公司新增订单总额为55.77亿元，其中5年以上长期订单总额为1.17亿元。在除去大宗气站、TGM、TCM等电子材料及专项服务的长交期订单的影响后，2024年新签订单与2023年相比实现了17.88%的增长。2024年新增订单中来自集成电路行业的订单额占比达84.55%，其中服务于12英寸集成电路客户占比达88.46%，且主要为产业的一线用户，包括中芯国际、华虹公司、上海华力、长鑫科技、长江存储、北电集成、燕东微、士兰微、润鹏半导体、H系等。   1. **请问公司目前收入确认和经营性现金流情况如何？**   答：公司主营业务为集成电路及泛半导体产业客户提供高纯工艺系统、半导体湿法设备及电子材料。随着近两年营业收入的增长，带来了应收账款余额的同比增长，且公司业务主要集中于集成电路行业，合同金额档位和项目规模也在逐年扩大，项目周期也相应拉长，收入确认需在全部设备联调供应验收完成，而应收款方面，因部分客户付款审批流程长、系统集成项目审计周期不可控等综合影响了部分应收账款的回款速度。近两年由于公司重点发展12寸集成电路制造领域的客户，且已经取得初步成效，新签订单及收入的集中度逐渐提升，且客户回款情况良好。  近几年经营性现金流持续净流出主要原因为：第一，受集成电路国际形势收紧等影响，公司进行了战略性的管制品备货；第二，主要系公司在半导体湿法设备及电子材料业务板块持续的投入；第三，公司加大研发先进制程产品的投入。但随着电子材料及设备业务逐步获得客户验证，开始形成重复订单，现金流逐步改善，2024年开始经营性现金流净流出明显收窄，2025年一季度单季经营性现金流净流出较上年同期收窄接近2个亿。   1. **关注到公司存货较多的原因是什么？**   答：2024年公司存货期末余额为31.51亿元，同比增长17.87%，其中存货中原材料、未完工项目施工及在产品占比分别为31.23%、30.18%及25.38%。存货中包括系统集成及材料业务的未完工项目及为保证业务扩张而储备的原材料和零部件等。公司在2024年底被美国商务部工业和安全局列至出口管制实体清单，叠加集成电路行业的外部环境变化，为保障业务的连续性，一方面公司采取了较为积极的备货策略，另一方面积极进行在地化供应链的开发。国内半导体设备制造企业，均处于相同的行业背景中，针对供应链风险，采取的应对措施相似。因此随着公司业务的增长，存货增长，与行业发展趋势一致。 |